

Title (en)

FILLING-IN PASTE FOR ELECTRONIC COMPONENTS.

Title (de)

PASTÖSE FÜLLUNG FÜR ELEKTRONISCHE BAUTEILE.

Title (fr)

PATE DE REMPLISSAGE POUR COMPOSANTS ELECTRONIQUES.

Publication

EP 0612434 A1 19940831 (EN)

Application

EP 93912548 A 19930701

Priority

- CS 276592 A 19920907
- CZ 9300016 W 19930701

Abstract (en)

[origin: WO9406125A1] The filling-in paste for electronic components is produced as the reaction product of anhydrous ricine-oil and polyizocyanate-resin in weight ratios from 100:5 to 100:25 and it is thermosetting in temperature range 0 to + 75 C and by duration from 20 minutes to 6 hours.

Abstract (fr)

On produit une pâte de remplissage pour composants électroniques en faisant réagir une huile de ricine anhydre avec une résine de polyisocyanate dont les rapports de poids peuvent varier entre 100 à 5 et 100 à 25 et en faisant thermodurcir le produit obtenu entre 0 et 75 °C entre 20 minutes et 6 heures.

IPC 1-7

H01B 3/30; **C08G 18/36**

IPC 8 full level

C08G 18/36 (2006.01); **H01B 3/30** (2006.01)

CPC (source: EP)

C08G 18/36 (2013.01); **H01B 3/302** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9406125A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9406125 A1 19940317; CZ 276592 A3 19930317; CZ 279560 B6 19950517; EP 0612434 A1 19940831; RU 94022273 A 19960727; SK 276592 A3 19940608; SK 278230 B6 19960508

DOCDB simple family (application)

CZ 9300016 W 19930701; CS 276592 A 19920907; EP 93912548 A 19930701; RU 94022273 A 19940505; SK 276592 A 19921107